

2012年3月期 業績予想説明会資料

2011/6/8

◎株式会社日立ハイテクノロジーズ

執行役社長 久田 眞佐男

Copyright©2011 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

2012年3月期 業績予想説明会

I 2012年3月期 経営方針

II 2012年3月期 業績予想

I 2012年3月期 経営方針

(注)YY/MはYY年M月期を表しています。

企業ビジョンの実現

「ハイテク・ソリューション事業におけるグローバル・トップを目指す」

1. 成長分野へのリソースシフトと新ビジネスモデルの創出
2. グローバル事業の強化による高収益構造への転換
3. 次期成長に向けた強固な経営基盤の構築
4. 連結経営の深化とキャッシュ・フロー経営の強化
5. CSRを意識した経営の推進と人財の計画的育成

日立ハイテク那珂事業所・(株)日立ハイテクマニファクチャ&サービス 復旧状況および復興計画について

1. 建屋復旧状況

- 5月6日に全職場の移設・立ち上げを完了
- 2008年度から推進している耐震・モノづくりの整備計画を変更。
総額約50億円の追加投資により、新建屋の建設、生産の効率化と
能力の向上を促進

2. 生産立ち上げ状況

6月までに各ラインの生産能力およびロジスティックス機能を増強し
7月からの増産に対応

サプライチェーンの状況

サプライチェーンの状況は日を追って回復。市中品の確保や代替品の評価等により、更なるリスク低減を推進中

電力供給問題への対応

- 日立グループの休日輪番、夏期休暇分散への参画および当社独自の節電対策と合わせ15%節電(*)に取り組む予定

(*)東京電力および東北電力管内における昨年の使用最大電力値の15%以上
(対象期間:東京電力管内 2011年7月1日~9月22日、東北電力管内 2011年7月1日~9月9日)

- 自家発電導入については、法令上の課題等への対応を含め、BCPの観点から今後も継続検討

Ⅱ

2012年3月期 業績予想

(注)YY/MはYY年M月期を表しています。

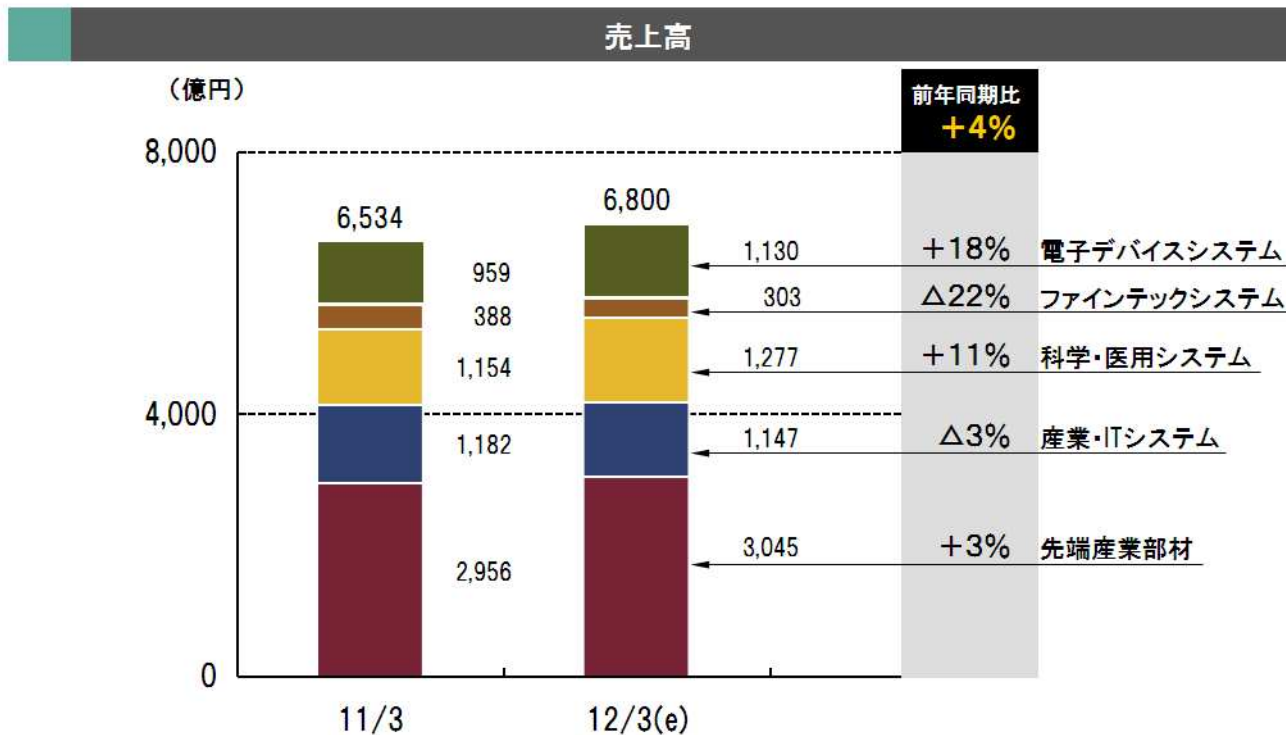
2012年3月期業績予想(ハイライト)

(億円)

	当年度予想	前年度実績	前年同期比	
			増減額	増減率
売上高	6,800	6,534	+266	+4%
営業利益	280	279	+1	+0%
経常利益	280	295	△15	△5%
当期利益	180	178	+2	+1%
一株利益	130円87銭	129円07銭	1円80銭	
一株配当	20円00銭	20円00銭	±0円00銭	
ROE	7.2%	7.5%	△0.3%	
FIV	+44	+59	△15	
FCF	+150	+221	△71	

(注)想定レート: 1USD=80円
1EUR=115円

2012年3月期業績予想(セグメント別売上高)



(注)合計にはセグメント間の内部取引の消去等が含まれております。

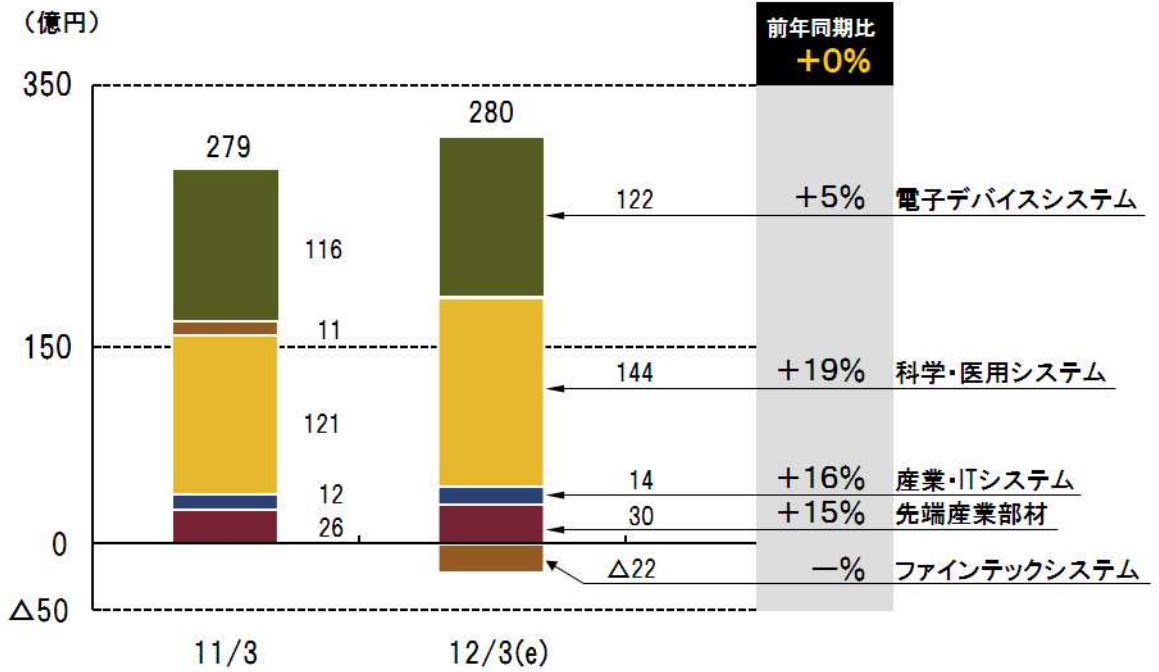
Copyright©2011 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

9

■前年同期比増減説明

- ・電子デバイスシステム
大手デバイスメーカーの微細化・量産投資の取り込み等により前年同期比+18%を予想
- ・ファインテックシステム
中国市場における液晶パネル生産投資計画の遅延や業界再編等によるHD関連製造装置への一時的な投資停滞等により前年同期比△22%を予想
- ・科学・医用システム
欧州や中国を中心としたアジア諸国向け解析装置・医用分析装置の好調等により前年同期比+11%を予想
- ・産業・ITシステム
震災の影響による車載用HDDの販売落ち込み等により前年同期比△3%を予想
- ・先端産業部材
中国向け太陽電池関連部材の需要回復等により前年同期比+3%を予想

営業利益



(注) 合計にはセグメント間の内部取引の消去等が含まれております。

Copyright©2011 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

■前年同期比増減説明

各セグメント共、売上高とほぼ同様の理由により営業利益が増減すると予想

11年度事業環境と当社の対応

半導体デバイス市場

- スマートフォンやタブレット端末などのモバイル関連機器の好調により、11年度の半導体デバイス市場は6%前後の堅調な成長を見込む
- 11年度もNAND、MPU、ASSPとも成長の見通し。DRAMは10年度後半からのPC需要の低下により△10～15%のマイナス成長を見込むも、モバイルDRAMの需要は好調
- 東日本大震災の世界市場全体に与える影響は限定的

半導体製造装置市場

- 市場全体では10年度4Qまで7四半期連続のプラス成長
- 11年度は約7%の市場成長を見込む。10年度後半の積極投資の影響で11年度設備投資は後半追い込み型と予測
- 最先端ロジック、MPU、NAND(2Xnm)の量産移行への投資が進みMPU、NANDメーカーおよびファウンドリ中心に新規ファブ建設予定

実装装置市場

- 11年度は中国市場を中心に台数ベースでは増加するも、ASP下落により金額ベースでは10年度同等規模を見込む

Copyright©2011 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

11

■半導体デバイス・製造装置市場動向

引き続きスマートフォンやタブレット端末などのモバイル関連機器の好調により、それらに搭載されるNANDフラッシュ、ASSPを中心に半導体デバイス市場は堅調な成長が見込む

11年のPC台数成長率は、需要の低下から一桁台に止まることが見込まれるため、DRAM全体では販売高のマイナス成長を予測。DRAM各社は需要の高いモバイルDRAMの生産比率増大、あるいはDRAM以外の製品(例えばNORフラッシュ)への生産シフトを計画

半導体市場の成長に支えられ、半導体製造装置市場も09年度1Qをボトムに7四半期連続のプラス成長ファウンドリなどで10年度4Qに投資集中があり、11年度前半は一服して、後半には再びメモリーメーカーを中心に投資加速を見込む。MPU、ファウンドリ、NANDの微細化投資が中心で新規ファブ建設も開始

実装装置市場はスマートフォンを始めとするモバイル関連機器に支えられ、中国市場を中心に11年度も好調

半導体デバイスの微細化動向について

半導体デバイス・プロセス技術への要求

スマートフォン・タブレット端末などモバイル関連機器が半導体技術を牽引

- ・微細化による一層の小型化・実装面積の縮減
- ・低電力化によるバッテリー消費の抑制(表1)

次世代トランジスタ技術の動向

- ・微細・低電力実現のため、現在主流のプレーナー型トランジスタから低電力デバイス構造である立体型トランジスタ(FinFET*)へ
- ・微細加工にはダブルパターニング(DP)を適用

当社の先端半導体プロセスへの対応

- ・FinFET用高精度エッチング技術の確立
- ・DP用高精度計測技術の確立
- ・先端デバイスメーカーとの開発段階からの協業
- ・微細化に対応し、微小欠陥検査技術の確立

*FinFET…Fin-type Field Effect Transistor

表1 消費電力のトレンド(ロジック) 2011年度比

年	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ITRS 2009版	1	0.94	0.90	0.84	0.76	0.72
ITRS 2010版	1	0.94	0.68	0.56	0.54	0.46

ITRS: International Technology Roadmap for Semiconductors

微細・低電力プロセス確立

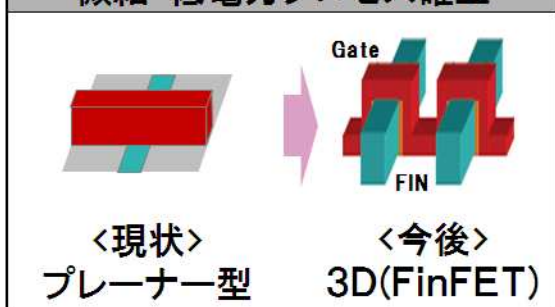


表2 素子分離～ゲート工程数比較(当社推定)

	プレーナー型 (従来構造)	FIN型 (立体構造)	3Dトランジスタ導入により当社対象市場の規模拡大
エッチング	8	10	
計測	14	16	

Copyright©2011 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved. 12

半導体デバイスの微細化動向について

・スマートフォンを始めとするモバイル関連機器が半導体デバイスを牽引、技術的な要求は以下2点

- ①微細化による小型化と実装面積の圧縮
- ②低電力化によるバッテリー消費の抑制

ITRSロードマップ上(表1)でも低電力化が加速、低電力化に対するニーズが高い

・低電力デバイスを実現するためのプロセス技術

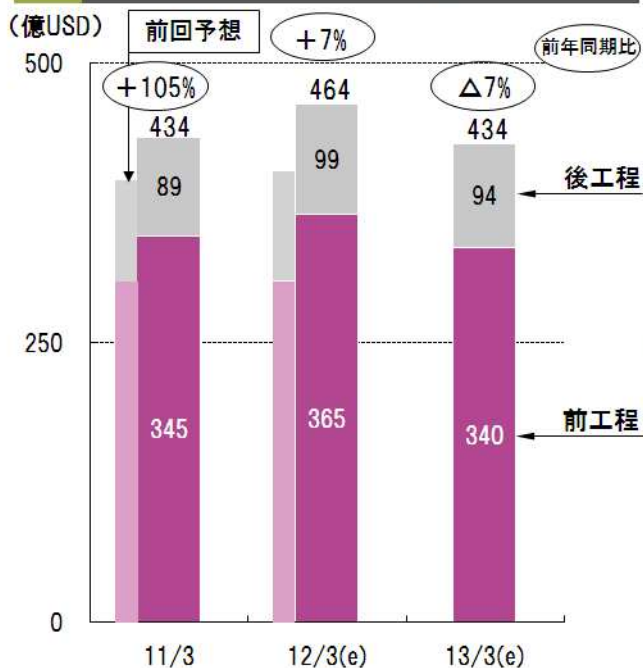
トランジスタ構造を従来のプレーナー型から立体構造へ変更、米国大手メーカーは量産準備中
プレーナー型・立体構造共、微細加工にはダブルパターニングを採用

・トランジスタ構造の変化により、当社事業に関わる工程の数は増加(表2)

こうした成長市場を獲得するため、当社では以下4点に注力

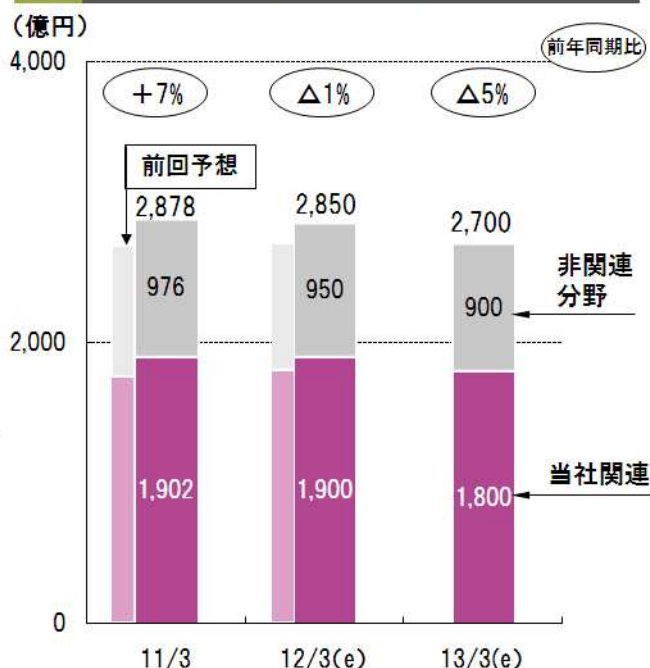
- ①3Dトランジスタ用高精度エッチング技術の確立
- ②ダブルパターニング用計測技術の確立
- ③先端デバイスメーカーと開発段階からコラボレーション
- ④微小欠陥に対応した欠陥検査技術を強化、歩留まり向上をサポート

半導体製造装置市場



(出所)Gartner(11年3月)に基づき当社作成
 前回予想は10年10月の11年3月期2Q決算発表時の見通し

実装装置市場



(出所)日本ロボット工業会資料(11年5月)調査機関資料に基づき当社作成
 前回予想は10年10月の11年3月期2Q決算発表時の見通し

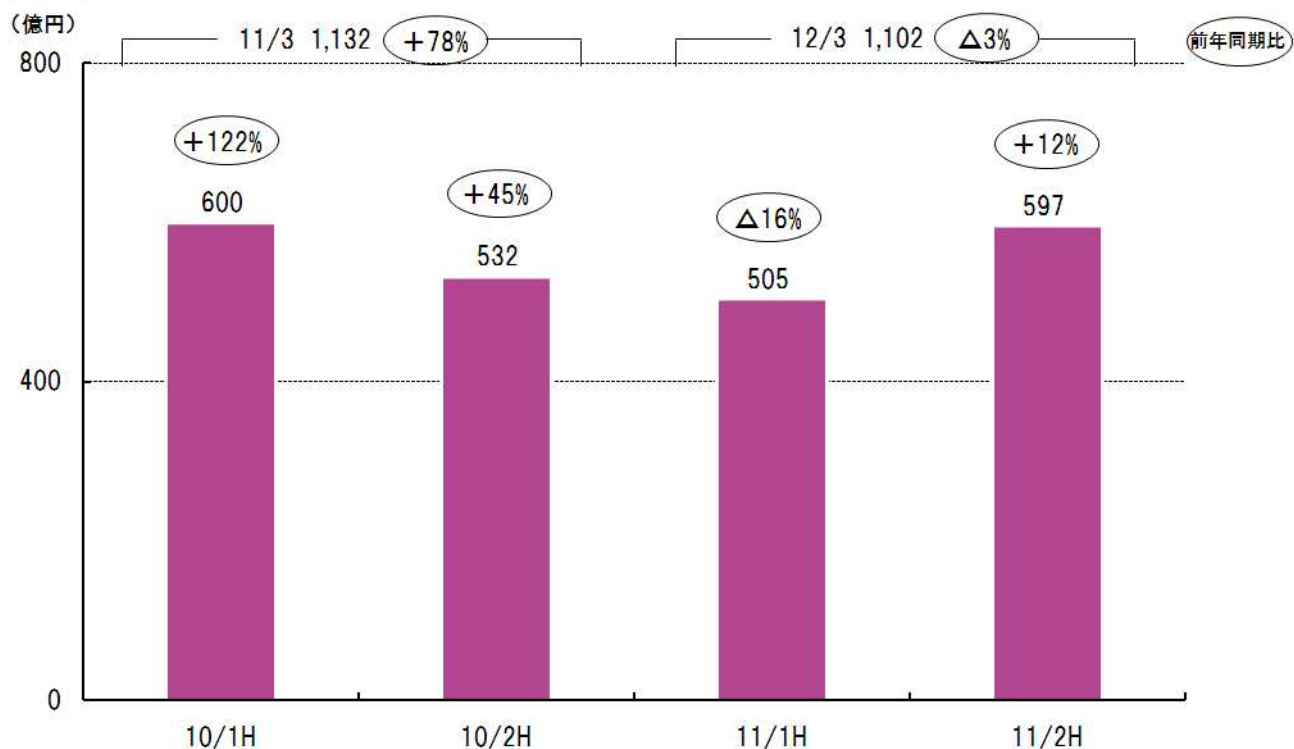
■半導体製造装置市場の状況説明

- ・11年度:ファウンドリやMPU、メモリーメーカーの積極投資により、+7%を予想
- ・12年度:ファウンドリ等の積極投資が一段落し、前年同期比△7%を予想

■実装装置市場の状況説明

- ・11年度:スマートフォンおよびタブレット端末等の生産増加により、実装装置も台数ベースでの増加を見込む。特に中国大手EMSでは生産増となる見通し。但し売価ダウンも想定され、市場規模は10年度並(△1%)を予想
- ・12年度:中国向け大手EMSの増産投資の一巡等により、前年同期比△5%を予想

受注高の推移



Copyright©2011 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved. 14

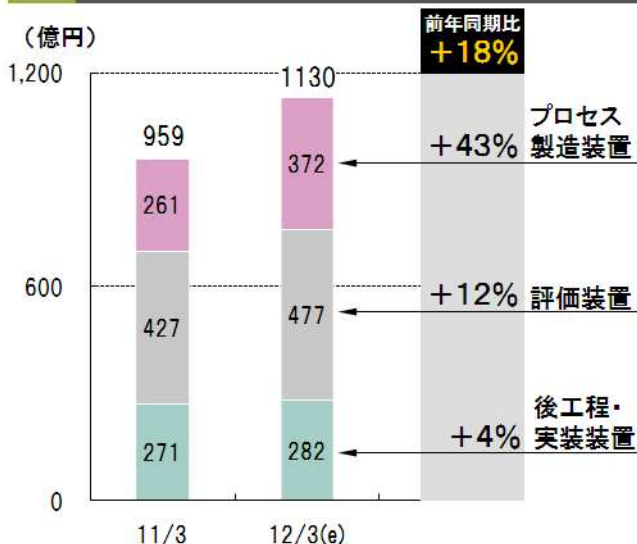
■受注高の推移

- ・11/上: 震災の影響等により、前年同期比△16%を予想
- ・11/下: 年度後半は回復基調となり、前年同期比+12%を予想

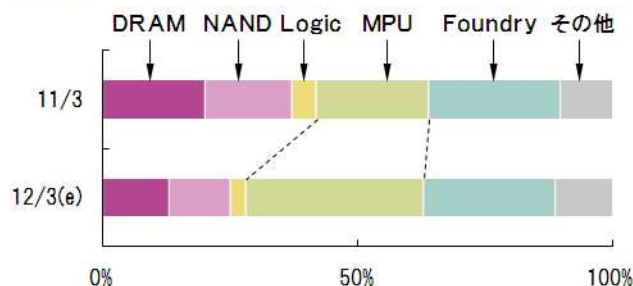
11年度基本戦略

1. 主力製品の売上拡大と新製品の市場投入による顧客数拡大
2. マーケティングの強化とグローバル展開による成長戦略の実行

主要製品群別売上高の推移



前工程装置 分野別売上高比率



10年度: 前半はメモリー関連で大型投資あり。ファウンドリでも大型投資が継続

11年度: MPUの積極的投資により比率上昇、ファウンドリも引き続き堅調

Copyright©2011 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

■基本戦略に対する今後の取組み

1. 主力製品の売上拡大と新製品の市場投入による顧客数拡大
 - ・ゲートエッチャーの売上拡大
 - ・CD-SEM、ダイボンダーの次世代プロセスへの対応推進
 - ・検査装置の顧客数拡大
2. マーケティングの強化とグローバル展開による成長戦略の実行
 - ・先端顧客との開発連携強化
 - ・マルチナショナル化する顧客への営業・サポート体制強化
 - ・伸長地域、成長分野顧客の重点攻略

■11年度 前年同期比増減説明

プロセス製造装置

・主要顧客の積極投資および適用プロセス拡大等により、前年同期比+43%を予想

評価装置

・大手顧客の投資取り込み等により、前年同期比+12%を予想

後工程・実装装置

・中国等伸長市場におけるマーケティング強化により、前年同期比+4%を予想

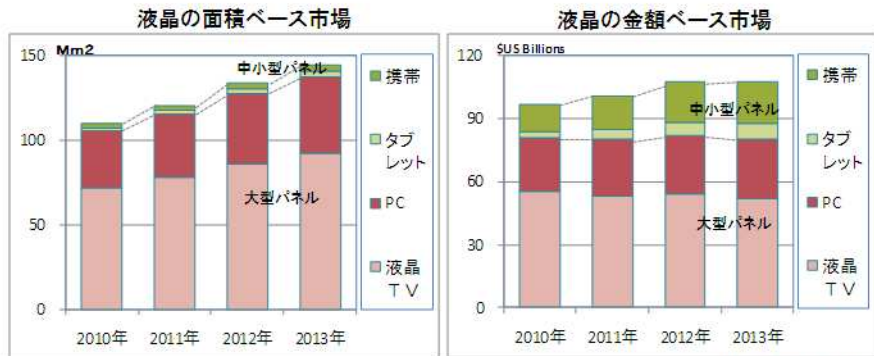
■11年度 前工程装置 分野別売上高比率

- ・MPUメーカーの積極投資により売上高増大
- ・ファウンドリも引き続き堅調な投資が見込まれ、売上高は伸長

11年度事業環境

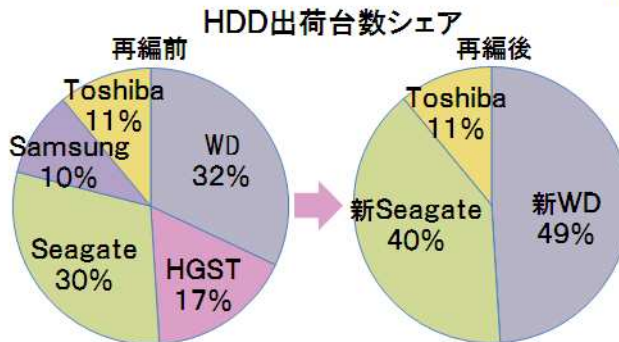
FPD業界動向

- ・大型パネル市況の悪化による中国投資の遅れ
- ・中小型関連(モバイル・タッチパネル)市場が好調



HD業界動向

- ・業界再編により市場環境が変化
- ・WDによるHGST買収(2011年10-12月期)
- ・SeagateによるSamsung HD事業買収(2011年12月)



出所: インフォメーションテクノロジー総合研究所 シェア(GY2010) シェア変動の可能性

Copyright©2011 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

FPD業界動向

大型パネル市況の悪化

TV、PC用の大型パネルは価格低下により、面積ベースでは成長を続けるが金額ベースでの市場は鈍化

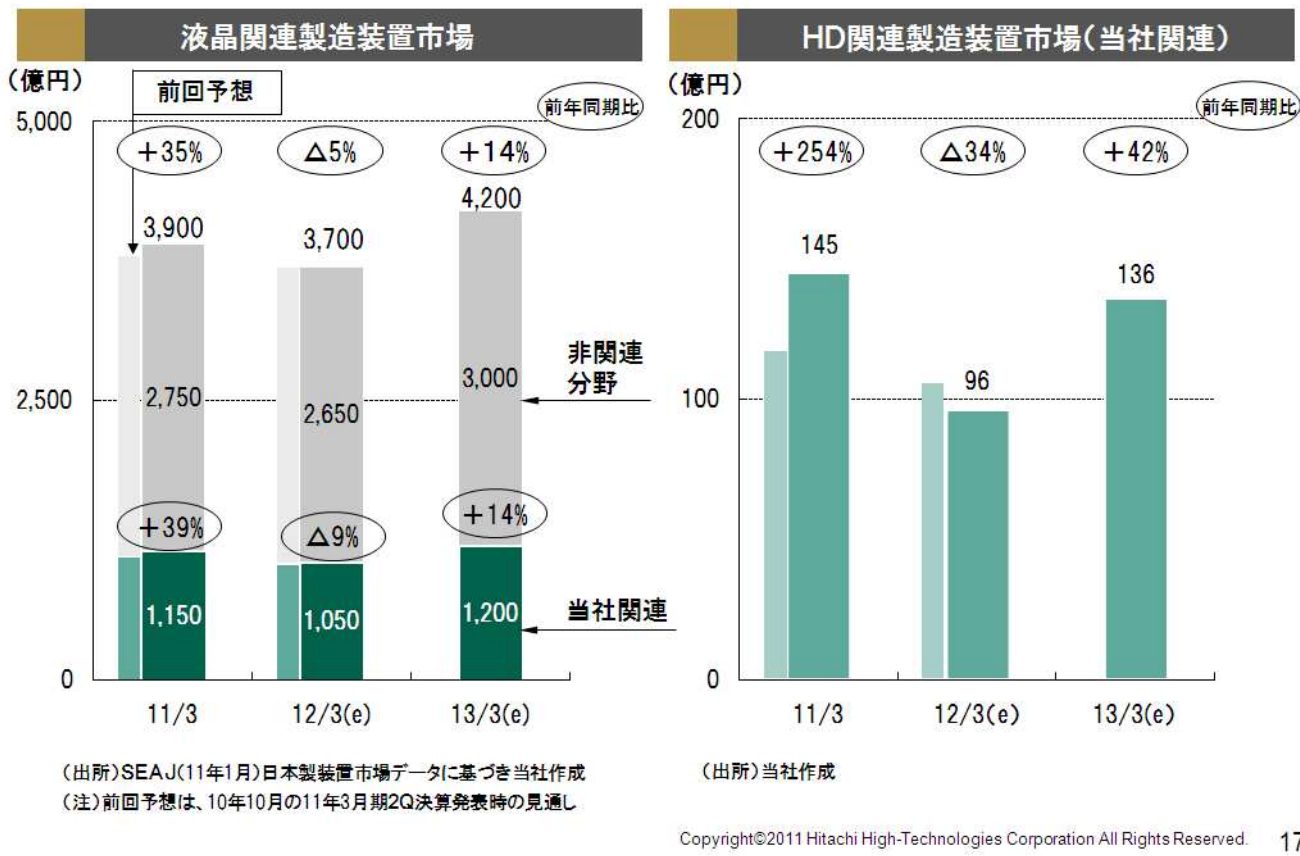
スマートフォン・タブレット端末の好調により中小型パネルの市場は成長が続く

HD業界動向

業界再編

2011年はHD業界再編後の業界地図を見極める年

- ・東芝(調達型)のシェア動向
- ・新WD、新Seagateの内製化の動向



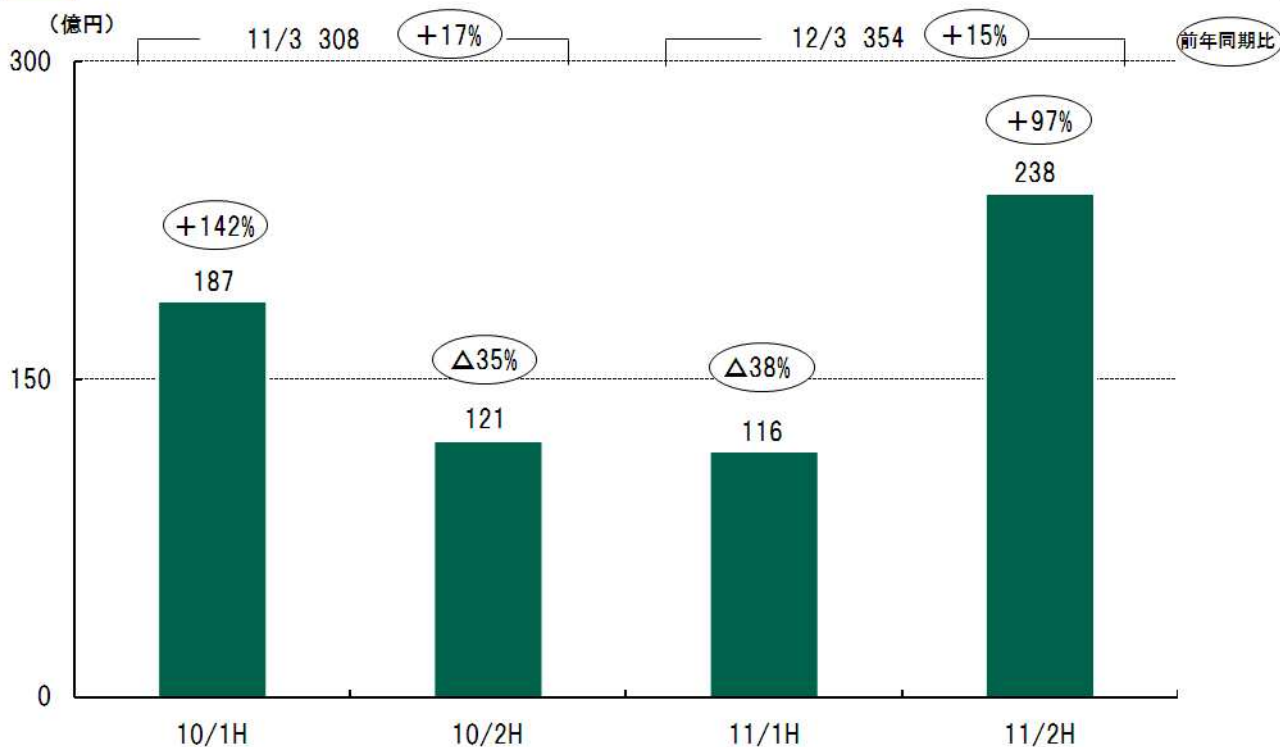
■液晶関連製造装置市場概況

- ・11年度：
遅れていた韓国・台湾の中国投資案件は、ようやく開始されたが当初の予定より大幅に遅れ、投資規模・時期は依然として不透明で、前年比△5%の見込み
- ・12年度：
韓国・台湾の中国投資案件および中小型液晶パネルへの投資増加等により、前年比+14%を予想

■HD関連製造装置市場概況

- ・11年度：
業界再編や、東日本大震災の影響で投資計画の遅延が見込まれ、前年比△34%の見込み
- ・12年度：
11年度投資延期分の回復等により、前年比+42%を予想

受注高の推移



Copyright©2011 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved. 18

■受注高の推移

- ・11/上: 前年同期比Δ38%、前期比Δ4%を予想

FPD

露光・実装装置とも大型パネル向けの投資の計画遅延

HD

新コンセプトによるディスクテスタ拡販

新型ガラスサブストレート表面検査装置の市場投入開始による受注増を見込む

- ・11/下: 前年同期比+97%、前期比+105%を予想

FPD

中国を中心とした、大型パネル投資関連設備の増加を見込む

HD

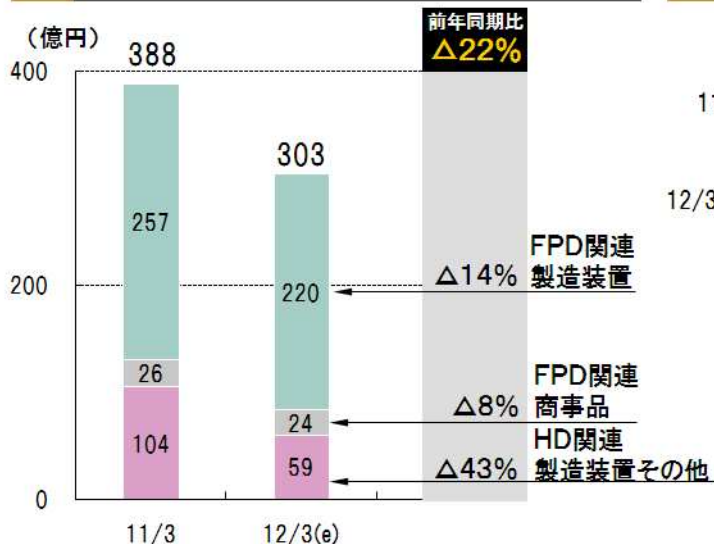
ディスクおよびガラスサブストレート増産向け検査装置の拡販

ヘッド素子形状検査装置の既存顧客の深耕と新規顧客参入

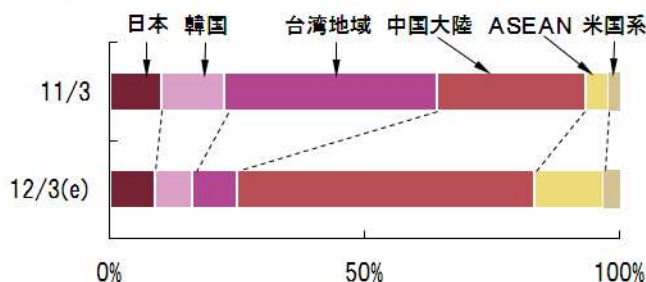
11年度基本戦略

1. 既存製品の競争力向上と新製品拡販による事業拡大(新型実装機・ハードディスク検査装置)
2. 新規事業の開発加速(有機EL製造・検査装置)
3. 市場変動に強い事業体制への転換(グローバル営業力強化・コスト競争力強化)

主要製品群別売上高の推移



地域別売上比率



- ・液晶関連の11年度の投資の中心は、中国大陸へシフト
- ・HD関連はASEAN地域が増加

Copyright©2011 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

19

■基本戦略に対する今後の取組み

1. 既存製品の競争力向上と新製品拡販による事業拡大
 - 1) 液晶関連
 - 中小型高精細パネル対応露光装置の競争力強化
 - 実装機新製品AL/AB9000シリーズの拡販
 - 2) HD関連
 - ①新製品の拡販
 - ・光学式ディスクテスタ RQ9000シリーズ
 - ・ヘッド素子形状検査装置 BM3100シリーズ
 - ・サブストレート用表面検査装置の機能向上
2. 新規事業の開発加速
 - 有機ELディスプレイ装置事業の立上げ
3. 市場変動に強い事業体制への転換
 - 1) 拡大市場へ営業力のシフト
 - 2) 調達、生産の改革によるコスト競争力の強化と短納期対応

■11年度 前年同期比増減説明

FPD関連製造装置

- ・前年同期比△14%を予想
- 中国向け露光装置の計画延期等による売上減

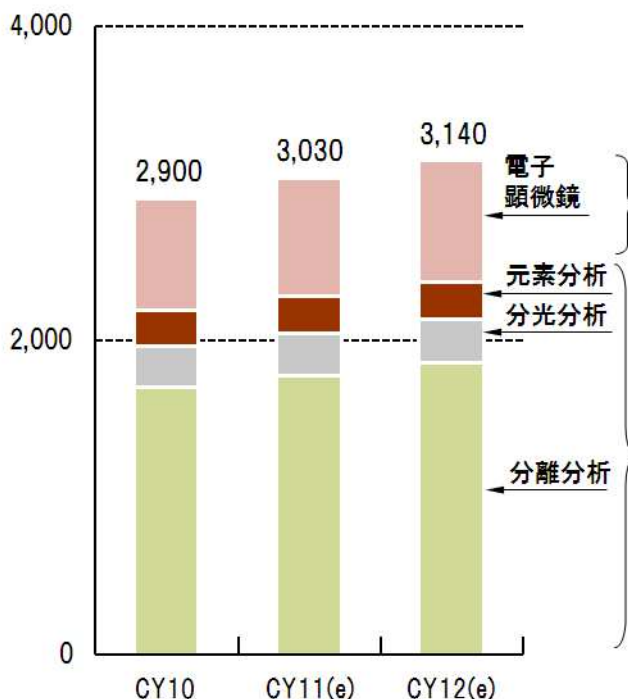
HD関連製造装置その他

- ・前年同期比△43%を予想
- 業界再編による投資決定遅れ等による売上減

分析・解析装置市場(当社関連)

11年度事業環境

(億円)(売上ベース) CAGR 4%



- 解析装置
 - ・リーマンショックによる景気低迷から民間市場の設備投資が回復傾向
 - ・特に新エネルギー・新材料関連市場からの需要が増加
- 汎用分析装置
 - ・汎用分析の中で、分離分析の市場規模が最も大きく、伸長率も年率5%と高い
- 市場における大震災影響
 - ・大きな影響はないと予想

(出所) SDI Global Assessment Report, Edition 10.5 等を基に当社推定

Copyright©2011 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

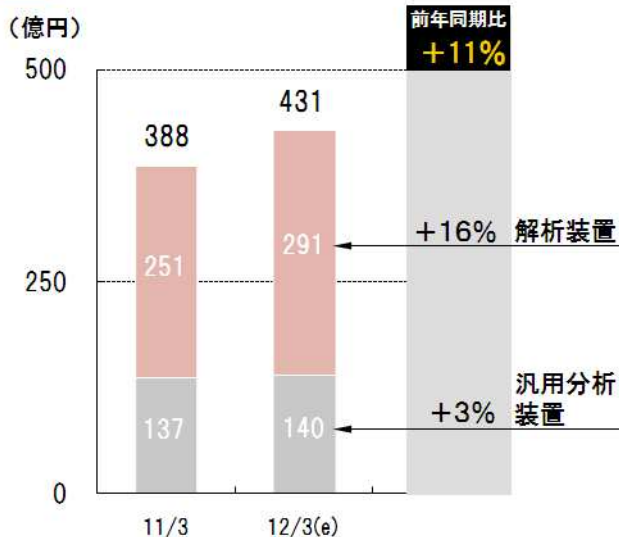
■ 分析関連事業の市場概況

- ・リーマンショック後の景気低迷から、徐々に民間市場の設備投資が回復。特に国内・アジアを中心に、新エネルギー・新材料関連の設備投資が活況。中国・新興国向けの需要が拡大。但し、円高基調により競合は激化
- ・分離分析・電子顕微鏡を中心に+4%のプラス成長を予想
- ・11年度のグローバル市場全体としては、大震災による大きな影響はないと予想

11年度基本戦略

1. 大震災からの早期挽回
2. 成長市場に対する新製品の拡販およびリソースの投入による売上拡大

売上高の推移



今後の取り組み

- 2Qからの増産体制による早期挽回
- 新型高分解能FE-SEMの拡販
- 新型液体クロマトグラフの製薬・食品市場向け拡販
- 中国市場へのリソース投入による売上拡大

Copyright©2011 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

21

■ 基本戦略に対する今後の取り組み

- ・新製品の投入に加え、アプリケーションの開発・充実による成長市場(燃料電池・PV・LED・製薬等)への積極的な拡販
- ・世界最高分解能観察を実現し、観察時の試料ダメージの軽減を可能にした新型FE-SEM(SU9000形)を2011年4月に発売開始。新エネルギー・新材料・半導体関連分野を中心に拡販
- ・データの再現性・安定性など基本性能の向上および簡単な操作、容易なメンテナンス、頑健性を実現した新型液体クロマトグラフ(Chromaster:クロムマスター)を2011年2月に発売開始。製薬・食品市場を中心に拡販
- ・中国における科学システムビジネスのパートナーである天美社との販売契約更新し、連携強化を実施。現地における販売・サービスサポート強化およびアプリケーションラボの設置により、アプリケーション対応強化を図る

■ 11年度 前年同期比増減説明

解析装置

- ・新製品投入効果等により、前年同期比+16%を予想

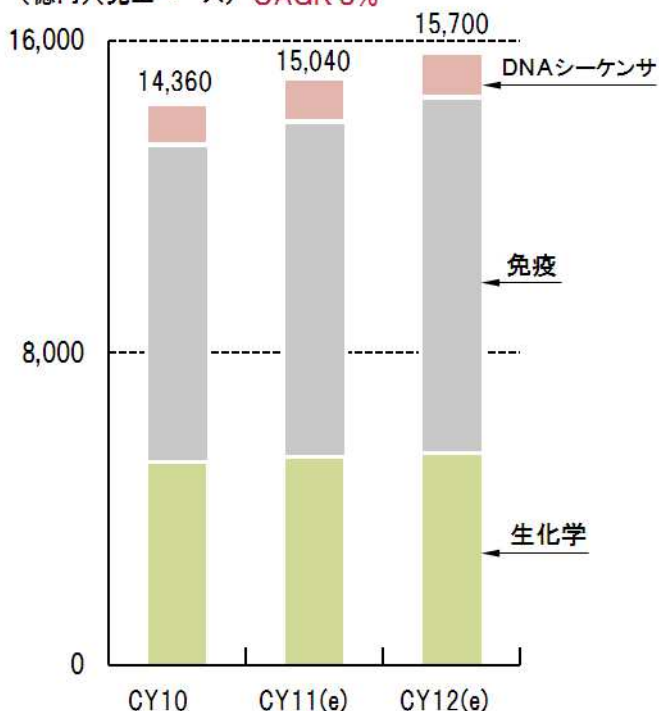
汎用分析装置

- ・新型液体クロマトグラフの拡販等により、前年同期比+3%を予想

バイオ・メディカル市場(当社関連)

11年度事業環境

(億円)(売上ベース) CAGR 5%



- 体外診断(生化学・免疫)
 - ・世界的な医療費抑制により、生化学分析市場ほぼ横ばい
 - ・免疫分析市場は年率6%成長を予想
- DNAシーケンサ
 - ・市場全体の伸びは年率6%を予想
 - ・第2世代シーケンサが市場を牽引
- 市場における大震災影響
 - ・大きな影響はないと予想

(出所)Kalorama Information 6th Edition(2008)他を基に当社推定(試薬、装置含む) Copyright©2011 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

■ バイオ・メディカル関連事業の市場概況

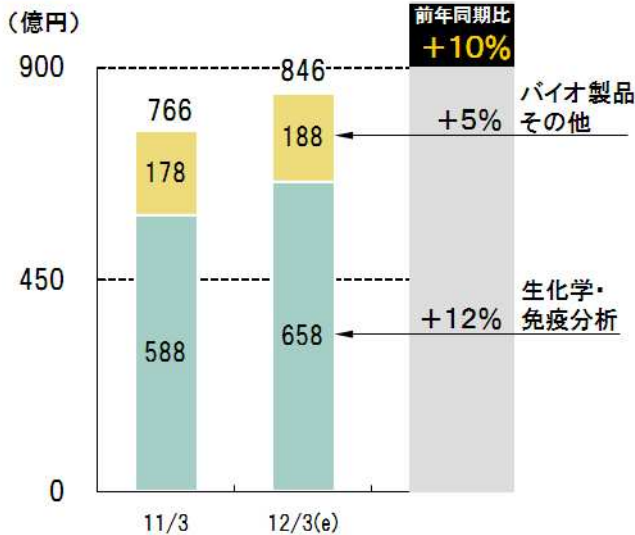
- ・生化学検査は医療機関における治療方針決定の際の基礎的な分析データとして用いられている。医療費抑制の影響はあるもののその重要性から今後も市場規模は維持されると予測。免疫検査市場では感染症やガンに対する新しいマーカー開発が進んでおり、今後も継続した市場拡大が期待される。病院の統廃合や検査センターの外注化等が進む一方、法規制強化により安全性及び品質規格適合要求が高まっている。
- ・DNAシーケンサは、第2世代シーケンサの牽引により、年率6%の成長を予想

11年度基本戦略

1. 大震災からの早期挽回
2. 国内外の有カメーカーとのSCB*継続推進による事業拡大

*SCB: System Collaboration Business

売上高の推移



今後の取り組み

- 2Qからの増産体制による早期挽回
- 海外パートナーとの連携強化による新大型生化学・免疫分析統合システムの拡販
- 5500型DNAシーケンサによる第二世代機市場への参入

Copyright©2011 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

■ 基本戦略に対する今後の取組み

- ・新大型生化学・免疫分析システム(cobas8000シリーズ)のワールドワイドでの販売加速支援
- ・第二世代機DNAシーケンサ(5500型)の販売立ち上げと現行機による遺伝子鑑定等の応用市場向けの拡販

■ 11年度 前年同期比増減説明

- ・新大型生化学・免疫分析統合システムの拡販等により、前年同期比+10%を予想

11年度基本方針

1. グローバルトップを目指せる事業分野へのシフト

- ・コアコンピタンスを生かした事業創造
- ・グローバル成長分野へのリソースシフトの加速化
- ・注力地域における現地有力パートナー企業との事業開発推進

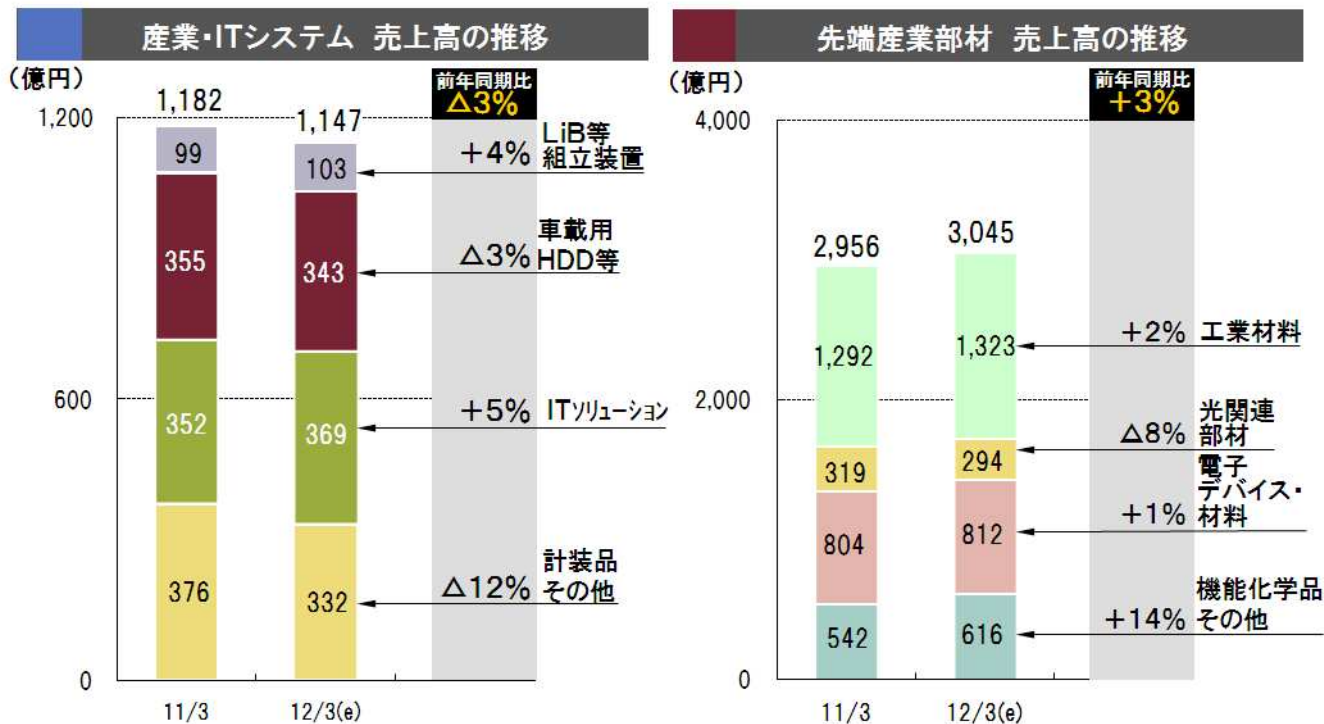
2. 重点地域(アジアベルト地域)戦略の加速

※アジアベルト地域・・・日本からアラビア半島に至るその間のアジア沿岸部
24カ国・地域

- インドネシアでの新エネルギー・
水ビジネスの拡大
- インドでの自動車関連ビジネス・
新エネルギー関連ビジネスの開発促進



2012年3月期業績予想 (産業・ITシステム/先端産業部材)②



Copyright©2011 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved. 25

■11年度 前年同期比増減説明

産業・ITシステム

- ・LIB等組立装置は、11年度前半は震災の影響があるも、自動車業界の11年度後半の回復を見込み、前年同期比+4%を予想
- ・車載用HDD等は、サプライチェーンの影響等により、前年同期比Δ3%を予想
- ・ITソリューションは、スマートフォン投入による携帯電話ビジネスの拡大により、前年同期比+5%を予想
- ・計装品その他は、一部商権の返上等により前年同期比Δ12%を予想

先端産業部材

- ・工業材料は、震災の影響により、11年度前半の自動車用部材の落ち込みがあるものの、太陽電池材料等の販売好調により、前年同期比+2%を予想
- ・光関連部材は、光通信用モジュールの需要回復を見込み、増加を予想するも、プロジェクト用光学部品取引等の減少により、前年同期比Δ8%を予想
- ・電子デバイス・材料は、一部商権返上による減少があるものの、スマートフォン用の部材等の販売拡大により、前年同期比+1%増加を予想
- ・機能化学品その他は、調達ソリューションビジネスの拡大等により、前年同期比+14%増加を予想

2012年3月期業績予想 (設備投資/減価償却費/研究開発費)

(億円)

	10/3	11/3	前年同期比	12/3(e)	前年同期比
設備投資額	94	90	△4%	184	+105%
減価償却費	96	90	△7%	101	+12%
研究開発費	193	208	+8%	258	+24%

(注)設備投資額は取得ベースにて記載

前年同期比 増減説明

設備投資額：94億円増加

- ・那珂事業所総合棟建設等

研究開発費：50億円増加

- ・自社製品の要素技術開発等

<資料取り扱い上の注意>

- ・本プレゼンテーションで述べられている決算概要及び業績予想は、注記がある場合を除き、すべて連結であり、億円未満を四捨五入しています。
- ・当社が開示する将来の業績見通しや戦略等に関する予想は、開示時点で知りうる情報や合理的と思われる前提をもとに策定しており、さまざまな外部要因による直接的・間接的な影響により、実際の当社の業績等が開示内容と異なる可能性があります。但し、開示内容との間に大きな乖離がある場合は、法令や証券取引所が定める適時開示規則並びに当社の自主的な判断に基づき、その都度開示していきます。

また、この資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

END

2012年3月期 業績予想説明会

お問合せ先

CSR本部 コーポレート・コミュニケーション部

部長 加藤 弘之

TEL:03-3504-5138 FAX:03-3504-5943

E-mail:kato-hiroyuki@nst.hitachi-hitec.com

日立ハイテク

最先端を、最前線へ。